

Однопроцессорные серверы Гравитон C1000И

Базовый элемент цифровой трансформации, разработанный и произведенный в России.



Оптимальное решение при соблюдении баланса производительности и эффективности

Процессор Intel® Xeon® Skylake SP, Cascade Lake SP, а также новейшие Cascade Lake Refresh и специализированная линейка процессоров Intel® Xeon® W3000. Тепловыделение поддерживаемых процессоров до 205 Вт. Шина UPI поддерживает скорость до 10,4 ГТ /с, на каждый процессор приходится до 28 ядер. Поддержка Intel® Turbo Boost, мультиточности и виртуализации.

8 модулей памяти DDR4 DIMM registered ECC с максимальным общим объемом до 1 ТБ. Возможна установка 4-х модулей DCPMM в качестве энергозависимого или энергонезависимого хранилища, которые можно использовать вместе с 4 модулями DIMM DDR4, составляя объем памяти до 2,5 ТБ (в конфигурации с модулями DCPMM 512 ГБ и DDR4 DIMM 128 ГБ), что позволит удовлетворить различные требования рабочих нагрузок. Частота используемой памяти может достигать 2933 МГц.

4 порта 1 Гбит/с Ethernet на материнской плате и отдельный выделенный порт управления, все они соответствуют сетевым требованиям в большинстве сценариев использования.

Уникальные платформы: разрабатываются и производятся в России

Серверы выпускаются в форм-факторах 1U и 2U в пяти вариантах исполнения с установкой на передней панели до 12 накопителей формата 3,5" или до 24 накопителей формата 2,5" и установкой на задней панели до 2 дополнительных накопителей формата 2,5" в форм-факторе 2U.

2 слота PCI-E x16, 3 слота PCI-E x8, и 1 слот PCI-E x4, позволяющих установить до пяти графических ускорителей с тепловыделением до 75 Вт каждый, а также сетевые карты FC до 64 Гбит/с или до 100 Гбит/с Ethernet.

Обилие необходимых портов на задней части корпуса: COM, VGA, 4x USB 3.0, 5x RJ-45 (1 IPMI), 2xAudio слот MicroSD с поддержкой гипервизора и возможностью использования в качестве загрузочного диска, специальные внутренние диски SATA DOM, внутренний слот USB и слот M.2 с ключом E для установки аппаратнопрограммных модулей доверенной загрузки (АПМДЗ).

Интеллектуальное управление, интеграция и открытость

Возможность удаленной и локальной инвентаризации устройства благодаря встроенному ПО и выдвижной электронной этикетке с информацией об изделии.

Поддерживается удаленная установка ОС, обновление прошивки BIOS и IPMI, создание собственных шаблонов ОС под конкретную конфигурацию, что сокращает время реагирования на возможные неисправности системы.

Интегрирован LED-дисплей для диагностики неисправностей и датчик вскрытия, позволяющие персоналу по эксплуатации и техническому обслуживанию быстро определять причину неисправности.

Для удобства эксплуатации реализовано безвинтовое крепление верхней крышки корпуса 2U, кареток накопителей, рельсов для монтажа в стойку и вентиляторов с возможностью горячей замены.

Запираемая на ключ фронтальная панель, идентификация сервера с обеих сторон, удобный кабельный органайзер. VGA порт на передней панели 2U для непосредственного подключения монитора.

Модельный ряд



Гравитон C1041И



Гравитон C1101И



Гравитон C1082И



Гравитон C1122И



Гравитон C1242И

Процессор нового поколения Intel® Xeon® Scalable 2-го поколения или Xeon W с теплопакетом до 165 Вт в форм-факторе 1U и до 205 Вт в форм-факторе 2U с 8 модулями DIMM DDR4 и DCPMM.

До двенадцати дисков 3,5" или двадцати шести дисков 2,5" (с использованием дополнительной корзины) для локального хранилища, возможность использования накопителей NVMe.

4 порта LAN 1 Гбит/с Ethernet на материнской плате, 2 аудио порта и до 6 слотов расширения PCI-E.

Удобство эксплуатации, продвинутые функции управления, точность и своевременность обнаружения неисправностей.

Безопасность систем и совместимость с популярными АПМДЗ и защищенными ОС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чипсет / Поколение	C621 / Intel Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake R					
Форм-фактор	Предназначен для монтажа в стойку, занимает 1U или 2U					
Процессор	1 процессор Intel® Xeon® Skylake SP, Cascade Lake SP или Xeon® W3000					
Объем памяти	До 1 ТБ (до 2,5" ТБ с использованием модулей NVDIMM)					
Количество разъемов	8 слотов для установки модулей DIMM					
Поддерживаемые модули	DDR4 RDIMM: 64 ГБ, 32 ГБ, 16 ГБ, 8 ГБ, LRDIMM: 128ГБ, 64ГБ					
Поддерживаемые типы памяти	DDR4 2400/2666/2933/3200 MHz DIMM Reg ECC					
Монтаж в 1U	C1041И			C1101И		
	4 накопителя 3,5"			10 накопителей 2,5"		
Монтаж в 2U	C1082И		C1122И		C1242И	
	Передняя панель	Задняя панель	Передняя панель	Задняя панель	Передняя панель	Задняя панель
	8x 3.5" SATA/SAS	-	12x 3.5" SATA/SAS	-	24x 2.5" SATA/SAS 16x 2.5" SATA/SAS + 8x 2.5" SATA/SAS/NVMe (опц.)	2x 2.5" SATA/SAS/NVMe
Порты ввода-вывода	На передней панели: 2x USB 3.0 На задней панели: COM, VGA, 4x USB 3.0, 5x RJ-45 (1 IPMI), 2x Audio					
Сетевые интерфейсы	4x 1 Гбит/с RJ-45 Выделенный порт управления (1 Гбит /с RJ-45)					
Слоты расширения	Монтаж в 1U			Монтаж в 2U		
	1x PCI-E 3.0 x16 или 2x PCI-E 3.0 x8			2x PCI-E 3.0 x16 3x PCI-E 3.0 x8 1x PCI-E 3.0 x4		
Разъем для АПМДЗ	M.2 с ключом E (2230, 2242, 2260, 2280)					
Поддержка GPU	До пяти графических процессоров тепловыделением до 75 Вт в корпусе 2U в форм-факторе LowProfile					